



カーボンニュートラルに貢献するパワー半導体の 現状・課題・将来展望

◇ 日時: 2022 年 8 月 22 日(月) 13:00~17:40

◇ 場所: 東京工業大学 大岡山キャンパス デジタル多目的ホール

<https://www.dst.titech.ac.jp/outline/facility/hall.html>

カーボンニュートラルな世界の実現に向けパワー半導体の需要増が見込まれており、パワー半導体への性能要求も高まっている。本研究会では、Si(シリコン)、SiCパワー半導体についての現状および実用化の加速に向けた課題や将来展望に加えて、パワー半導体も含めた半導体市場を取り巻くマクロ環境・グローバル動向について理解を深め、今後の取り組みについて議論する。

プログラム

13:00~13:05 開会の挨拶

13:05~13:50 「DX/GX で次の成長期に入る半導体産業と日本のポジション」

南川 明 (OMDIA(インフォマインテリジェンス合同会社))

13:50~14:35 「拡大する SiC マーケットと Si と SiC の使い分けについて」(仮)

藤森 正然 (インフィニオン テクノロジーズ ジャパン(株))

14:35~15:20 「パワーエレクトロニクスのシステム価値と接合技術」

齊藤 克明 ((株)日立パワーデバイス)

15:20~15:40 休憩

15:40~16:25 「SiC パワー半導体の最新動向」

香川 泰宏 (三菱電機(株))

16:25~17:10 「半導体産業の過去・現在・未来」

服部 毅 (Hattori Consulting International 代表)

The Electrochemical Society (ECS)フェロー・終身名誉会員)

17:10~17:40 総括

■ 参加受付: WEB 参加受付システム([ここをクリック*](#))から参加登録と参加費のオンライン決済をお願いします。席数に限りがあるため早期に参加受付を終了することがあります。

*本案内が印刷物の場合、<http://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai22.pdf> よりアクセスして下さい。

■ 参加費: (消費税込み)

先進パワー半導体分科会会員* 4,000 円、分科会学生会員 1,000 円、一般 6,000 円、一般学生 1,000 円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

■ 感染症対策: 事前の検温にご協力頂き、発熱がある場合は当日のご参加はご遠慮下さい。また、会場入り口での再度の検温にご協力下さい(体温が 37.5 度以上ある場合、ご参加頂けません)。会場では、消毒およびマスクの常時着用をお願い致します。

問合せ先: (各種手続きに関するお問い合わせは応用物理学会事務局までお願いします)

細井 卓治 (関西学院大学)

e-mail: hosoi.takuji@kwansei.ac.jp

下山 学 (SUMCO)

e-mail: mshimoya@sumcosi.com

中川 聡子 (グローバルウェーハズ・ジャパン)

e-mail: satoko_nakagawa@sas-globalwafers.co.jp

※応用物理学会事務局・白石

e-mail: shiraishi@jsap.or.jp